

情况说明

本项目执行需进行新型 CMOS 器件加工及测试服务。因项目预算书未列出全部测试化验加工单位，故本次乙方单位上海金翅半导体科技有限公司未作相应体现。现根据实际需求，经技术达标情况及收费标准等多方面综合比较，上海金翅半导体科技有限公司符合本次加工测试服务需求，且本人与上海金翅半导体科技有限公司无任何关联关系，故选用该单位进行相关测试化验加工服务。

特此说明。

项目负责人（签字）：

院（系、所）公章：

